

## **CHE1519 SERINGA PASTA PE BAZA DE CUPRU 1.5ML**

*Solutia pe baza de cupru este conceputa pentru a umple spatiile foarte mici dintre un procesor si radiatorul acestuia, pentru a îmbunătăți procesul de racire . Pachetul contine o seringa cu solutie de cupru de 1,5 cm<sup>3</sup>.*

*Aplicati solutia pe procesor intr-un strat uniform si subtire apoi atasati radiatorul la procesor. Stergeti excesul de solutie care apare intre procesor si radiator.*

*Solutia nu este capacitiva, temperatura de lucru este cuprinsa intre -50<sup>0</sup>C si +170<sup>0</sup>C. Nu se evapora si nu curge la temperaturi mari.*